

ダイシングソー

【株式会社ディスコ DAD320】

【設備の特徴】

・シリコンウェハー、ガラス、セラミックなどをブレードを用いて高精度な切断や溝入れ加工を行う装置です。専用ブレードを使うことで、石英やサファイヤなど硬質材料、プラスチック材料、アルミニウムにも対応できます。

【設備の仕様概要、技術内容】

■主な特長

- ・双対物顕微鏡とCCDカメラでアライメントします（モニター画面上の倍率200倍）。
- ・Z軸の自動原点出しでブレードの摩耗量に応じて切り込み量を設定できます。
- ・加工はプログラミングにより自動で行うことができ、内容は保存できます。

■仕様概要

ワークサイズ	Φ160mm以内、厚さ3mm以下	
スピンドル回転数	3,000～40,000rpm	
ワークテーブルの最大ストローク	X軸	248mm
	Y軸	162mm
	θ軸	-10° ～+190°
切断速度	X軸	0.1～300mm/sec
	Y軸	0.2μm
最小移動量	Z軸	1μm
	θ軸	0.00225°



■効果が期待される利用分野

【活用例】

- ・基板や材料物性評価のための整形
- ・不良解析や断面観察のための加工
- ・溝入れ加工
- ・ハーフカットしたへき開面の作製

【適用材料の例】

- ・半導体基板、硬質材料基板
- ・ガラスエポキシ基板、フレキシブル基板
- ・フェライト磁石
- ・電気電子デバイス

【お問い合わせ先】

秋田県産業技術センター

電子光応用開発部 オプトエレクトロニクスグループ 内田 勝

TEL:018-862-3414 / FAX:018-865-3949

〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-11 / <http://www.rdc.pref.akita.jp/>